

センサー電極用銀ペースト

レーザー加工用銀ペースト

SNP-210L

特徴

Features
特徴

低銀含有率(既存製品比較 15~20%)により
低コストを実現 ピンホールやカスレのない
導電塗膜形成が可能

Low cost achieved by low silver content ratio
(15 ~ 20% compared to existing product).
Conductive coating without pinholes or
thin spots is possible to form.

低銀含量(即現有產品的 15~20%) 實現低成本
可形成無小孔或薄點的導電塗層

銀粉の分散性を向上させ
Ag の粗大粒子数を削減

Improved dispersibility of silver powder;
reduced number of large Ag particles.
改善銀粉の分散性、減少粗大 Ag 顆粒的數量

仕様

Specifications
規格**SNP-300L-SP2**

低温硬化においても良好な
導電性とレーザー加工性

Good conductivity and laser processability
even at low temperature curing.
即使在低温固化也具有良好的導電性和激光加工性

銀粉の分散性を向上させ
Ag の粗大粒子数を削減

Improved dispersibility of silver powder;
reduced number of large Ag particles.
改善銀粉的分散性，減少粗大 Ag 顆粒的數量

印刷用銀ペースト

LS-453-11

低温硬化対応印刷用銀ペースト

低温でも良好な導電性、密着性が得られ
塗膜表面は平滑性が高い

Low temperature curable silver paste for printing.
Good conductivity and adhesion achievable
even at low temperature, and the coated film
surface has high smoothness.
低温固化印刷用銀漿。即使在低温下也可獲得良好的
導電性和粘合性，并且塗膜表面具有高光滑度

微細な銀粉末を使用し
粗大粒子を削減

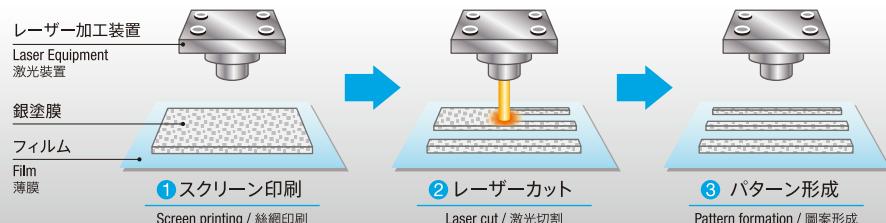
Fine silver powder used to reduce
large particles.
使用微細銀粉末以減少粗顆粒

| 特性項目 Characteristic items / 特性項目 | SNP-210L | SNP-300L-SP2 | LS-453-11 | 備考 Remarks / 備註 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 特徴 Features / 特徴 | レーザーカット用・低成本 For laser cutting・Low cost 激光切割用・低成本 | レーザーカット用・低温硬化 For laser cutting・Low temperature cure 激光切割用・低温固化 | 印刷用・低温硬化・低抵抗 For printing・Low temperature curing・Low resistivity 印刷用・低温固化・低電阻 | — |
| 粘度 (25°C) Viscosity / 粘度 | 300dPa·s | 400dPa·s | 400dPa·s | VT-06型粘度計 VT-06 type viscometer |
| 硬化条件 Curing condition / 固化條件 | 130°C×30min (PET / ITO) 150°C×30min (GLASS / ITO) | 80°C×30min (PET / ITO) | 80°C×30min (PET / ITO) | 熱風循環式乾燥炉 Hot air circulating drying oven / 热风循环式干燥炉 |
| 加工性 Processability / 加工性 | 20/20μm | 20/20μm | — | L / S 線寬距離 |
| 面積抵抗値 Sheet Resistivity / 面積阻抗值 | 70mΩ/□ | 70mΩ/□ | 40mΩ/□ | 膜厚 10μm 換算 Converted as 10μm thickness / 膜厚 10μm 換算 |
| 密着性 (PET) Adhesiveness / 密著性 (PET) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | クロスカット・テープピール Cross-cut, tape peel / 百格膠帶測試 |
| 用途 Application / 用途 | タッチセンサー電極回路 Electrode circuit of Touch sensor 觸摸傳感器電極電路 | タッチセンサー電極回路 Electrode circuit of Touch sensor 觸摸傳感器電極電路 | 指紋センサー・アンテナ受動部の電極 Fingerprint sensor・Electrode for passive part of antenna 指紋傳感器・天綫被動部分的電極 | — |

使用例

Usage Application
使用例子レーザー加工用
銀ペースト使用例

Usage application of Silver paste
for laser-process
使用銀漿進行激光加工的實例



加工性

Processability
加工性

L/S=30/30μm レーザーカット Laser cut / 激光切割

SNP-210L**SNP-300L-SP2**

平滑性 Smoothness / 平滑度

塗膜 表面粗さ Ra (μm)
Coated film Surface roughness / 塗膜表面粗糙度

0.42 LS-453-11



*本カタログ記載の数値は代表値であり、規格値ではありません。Numerical values shown on this catalog are typical values, not values of standard. / 本目錄記載的數值為代表值，並非規格值



株式会社アサヒ化学研究所

ASAHI CHEMICAL RESEARCH LABORATORY CO.,LTD.

製品に関するお問い合わせ先 For product inquiries / 產品查詢

TEL 042-644-2661 FAX 042-644-2621 http://asahi-kagaku.co.jp/